

# 川寶科技(股)公司

## 法人說明會

股票代碼：1595

主講人：川寶科技董事長

張鴻明

寶虹科技總經理

呂理宏

2017年11月10日



Equipment Solution & Service Provider For Wafer Fabrication System



# 免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。

本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動、市場需求以及其他本公司無法掌控之風險等因素。

本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或更新。

# 大綱



- 公司簡介
- 產品市場
- 營運績效
- 寶虹科技
- Q & A

# 公司簡介

- 創立日期:西元1999年02月19日
- 資本額:NTD 4.66億元
- 主要產品:  
CCD對位半自動曝光機、 CCD對位全自動曝光機及DI數位直接成像曝光機
- 重要事蹟:  
桃園縣政府表揚優良CSR公司  
中華民國第21屆國家磐石獎得獎公司  
社團法人中華公司治理協會CG 6008認證
- 公司員工:196名  
台灣母公司-85名美國研發實驗室4名泰國辦事處3名  
台灣子公司-寶虹科技股份有限公司55名 (2017年8月1日併入)  
大陸子公司-川康國際貿易(上海)有限公司22名  
川康國際貿易(上海)東莞分公司27名

# 公司簡介

川寶科技董事長:張鴻明/Wonder Chang  
國立交通大學EMBA管理碩士班  
中華民國第34屆創業楷模



寶虹科技總經理:呂理宏/Ray Lu  
國立交通大學EMBA管理碩士班



# 公司簡介

1999

公司成立  
以開發PCB曝光機為理念，期許全球PCB曝光機領導品牌。  
獲得日本USHIO公司在台灣區PCB燈管銷售代理。

2000

開發完成PCB專用CCD對位曝光機。

2001

成功開發完成第一台外層半自動曝光機。

2002

開發完成防焊半自動曝光機  
接獲瀚宇博德大陸新設廠訂單。

2003

接獲富士康煙台廠全廠訂單。

2004

購置內溪路新廠土地，建置新廠。

2005

遷址至內溪路新廠。獲得銘旺電子優良供應商獎。

2007

年營業額突破新台幣拾億元，  
年出貨量突破300台。獲得方正電子優良供應商獎。

2008

投入開發內層全自動CCD對位曝光機、  
外層全自動CCD對位曝光機。

2009

獲得ISO9001認證。

2010

開發完成內層全自動CCD對位曝光機、外層全自動CCD對位曝光機  
開發完成觸控面板曝光機。  
通過行政院中部科學園區高科技設備前瞻技術發展補助計畫。  
獲得深圳競華電子年度評比滿分第一名優良供應商獎。

2011

股票正式上櫃掛牌交易。  
榮獲縣政府表揚優良CSR公司。  
榮獲第34屆創業楷模及創業相扶獎。

# 公司簡介

2012

搬遷至長興廠，且榮獲第21屆國家磐石獎。

2013

投資美國Maskless Lithography Inc. 及與該公司技術合作共同開發全自動數位直接成像曝光機，並代理半自動數位直接成像曝光機。

2014

取得MASKLESS直接成像曝光機所有專利及相關設備。  
獲得社團法人中華公司治理協會 CG6008認證。  
台灣地區大型企業排名TOP5000，專用生產機業第38名。

2015

完成數位直接成像半/全自動曝光機技轉及在台製造。  
開發完成Phoenix 5000型多波長數位直接成像曝光機。  
開發陶瓷基板專用曝光機。

2016

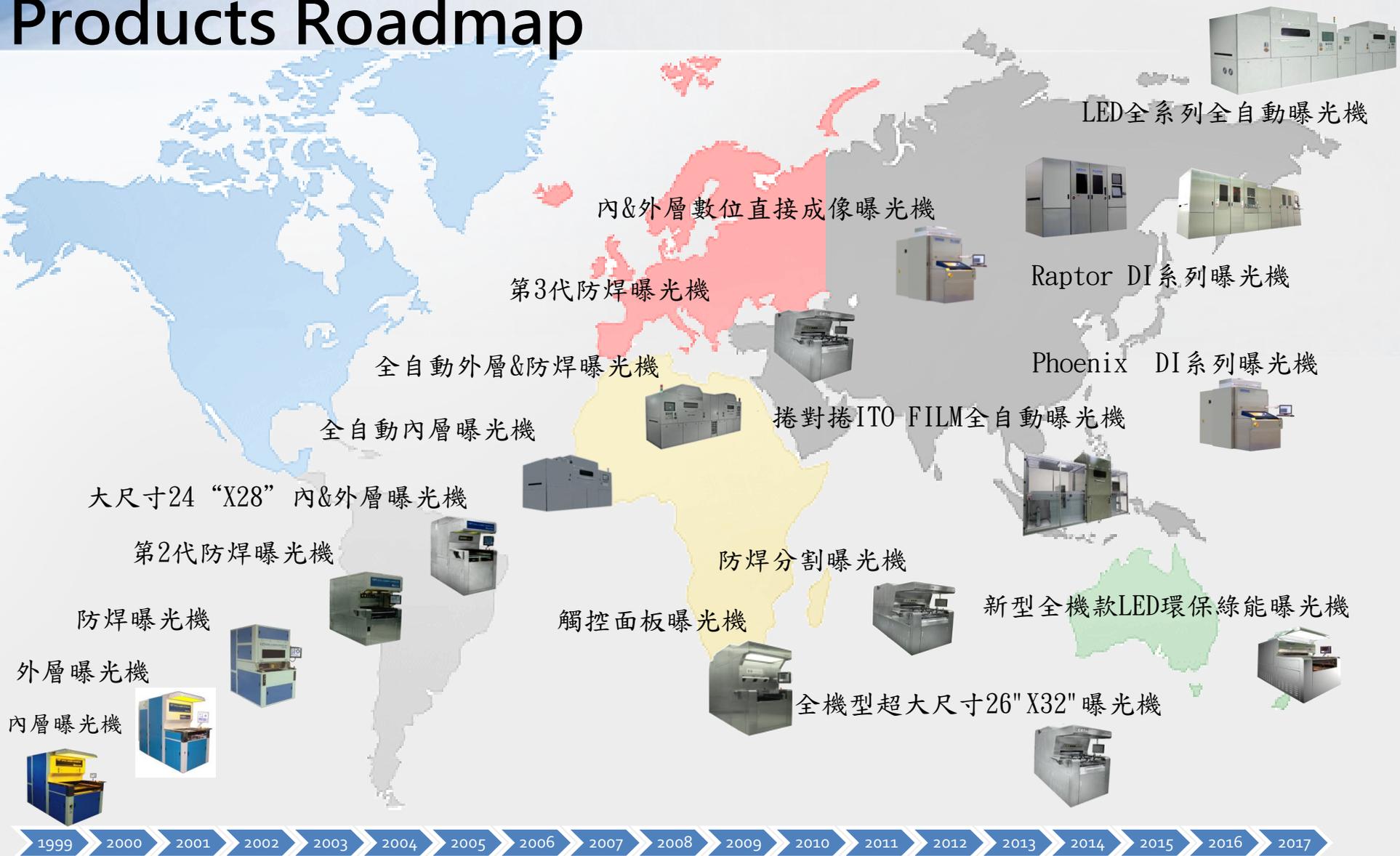
開發完成Raptor 7000型 35 $\mu$ m直接成像曝光機。  
開發全系列 UV LED環保綠能曝光機。  
參與經濟部工業局PCB曝光設備智慧參數設定與聯網技術開發專案。

2017

併購寶虹科技，進軍半導體產業

# 產品介紹

## Products Roadmap



# 產品介紹

## PCB 內層曝光機



Ledex-3500  
DFR/LPI Resister



Ledex-6907A/B  
LPI Resister



Ledex-6905AC/BC  
DFR Resister

## FPC/PCB 外層曝光機



Ledex-3500A  
DFR Resister



Ledex-2500  
DFR Resister



CBT-6805A  
DFR Resister



Ledex-6805A  
DFR Resister



Ledex-6705A  
DFR Resister

## FPC/PCB 防焊曝光機



Ledex-5000  
PSR Resister



CBT-810AC  
PSR Resister



CBT-910AC  
PSR Resister



Ledex-6710A  
PSR Resister



Ledex-8810  
預計2018Q1上市

## FPC/PCB DI 直接成像曝 光機



Raptor-7600  
DFR/PSR Resister



Titan-8000  
預計2018Q2上市

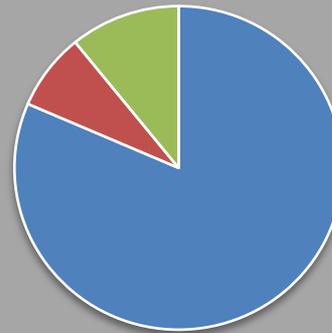


Titan-9000  
預計2018Q4上市

# 產品實績

全球裝機實績達3374台  
中國大陸、香港地區：2749台  
泰國、韓國及海外：259台  
台灣：366台

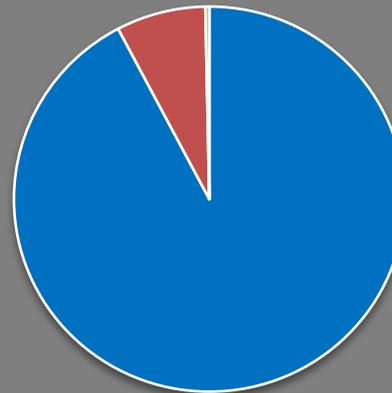
## 裝機實績



- 中國大陸、香港
- 泰國、韓國及海外
- 台灣

機種銷售比率：  
半自動曝光機 93.2%  
全自動曝光機 6.5%  
DI 直接成像曝光機 0.3%

## 機種銷售比率

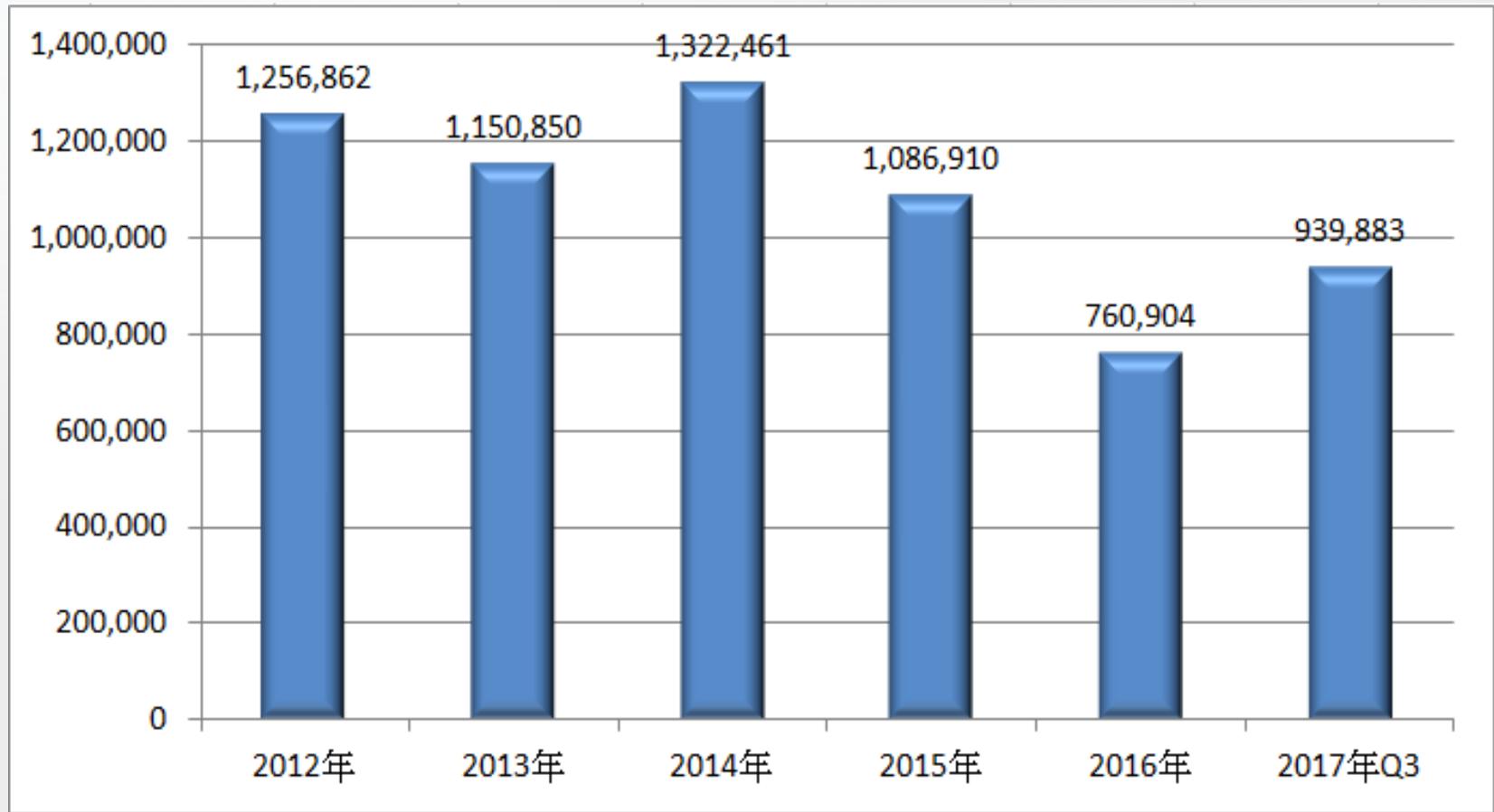


- 半自動曝光機
- 全自動曝光機
- DI 直接成像曝光機

# 營運績效

## 合併營收

單位:新台幣 仟元



註：2017年8月起合併營收包含寶虹科技

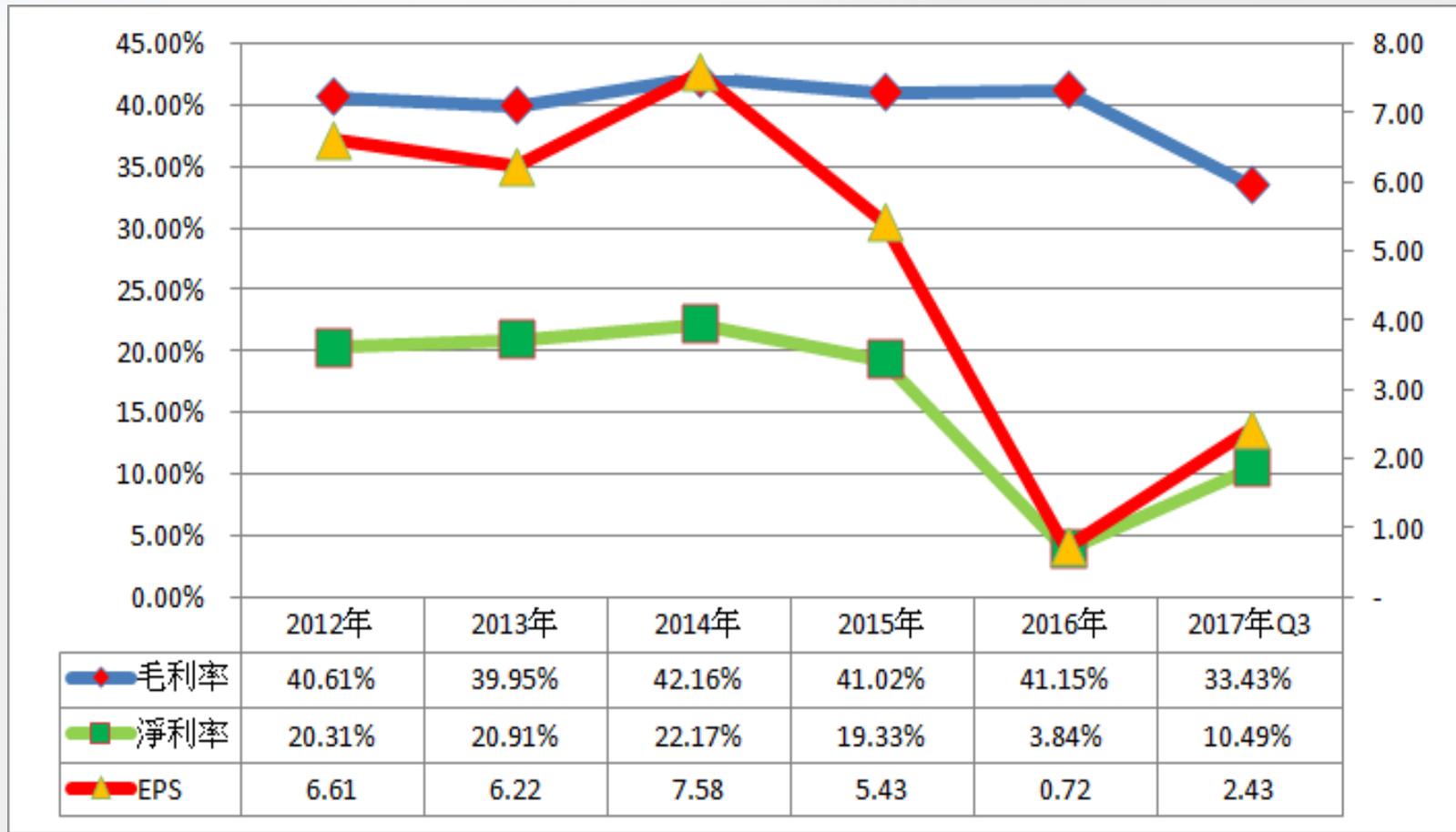
# 營運績效

## 毛利率/淨利率/EPS

EPS 單位:新台幣元

毛利率  
淨利率

EPS

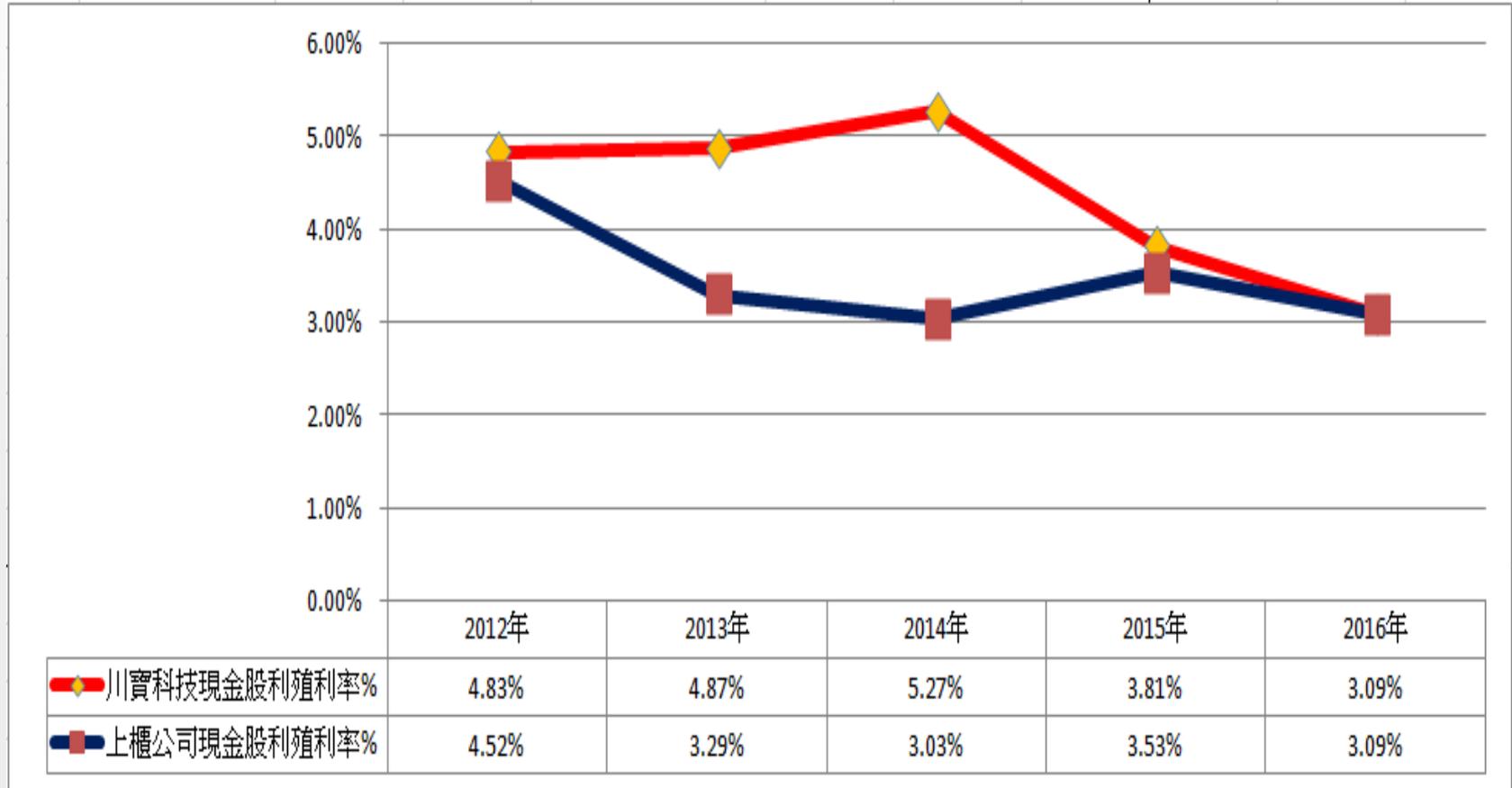


註：2017年8月起合併損益包含寶虹科技

# 營運績效

## 現金股利殖利率

現金股利殖利率%	近五年平均
川寶科技	4.37%
上櫃公司平均	3.49%



註：股價以當年度平均股價計算

上櫃公司現金殖利率資料來源：櫃買中心統計資訊

# 營運績效

## 合併綜合損益表

單位：新台幣 仟元

科目	2017年Q3	%	2016年Q3	%	YoY
營業收入	939,883	100%	589,912	100%	59%
營業毛利	314,232	33%	238,818	40%	32%
營業費用	159,917	17%	136,431	23%	17%
營業淨利	154,315	16%	102,387	17%	51%
營業外收支	-23,659	-3%	-23,513	-4%	1%
稅前淨利	130,656	14%	78,874	13%	66%
所得稅費用	32,073	3%	25,890	4%	24%
稅後淨利	98,583	10%	52,984	9%	86%
每股盈餘 (元)	2.43		1.30		

註：2017年8月起合併綜合損益表包含寶虹科技



# 營運績效

## 合併資產負債表

單位：新台幣 仟元

科目	2017年9月30日	%	2016年12月31日	%	2016年9月30日	%
現金及約當現金	827,877	24%	794,307	33%	715,290	30%
應收帳款及票據	520,491	15%	470,275	19%	504,252	21%
存貨	669,650	20%	384,377	16%	342,614	14%
其他流動資產	92,829	3%	53,011	2%	55,123	2%
<b>流動資產總計</b>	<b>2,110,847</b>	<b>62%</b>	<b>1,701,970</b>	<b>70%</b>	<b>1,617,279</b>	<b>67%</b>
不動產廠房設備	644,612	19%	492,705	20%	499,062	21%
投資性不動產	104,508	3%	105,397	4%	105,694	4%
無形資產	535,526	16%	112,513	5%	115,978	5%
其他非流動資產	19,634	1%	4,758	0%	80,254	3%
<b>資產總計</b>	<b>3,415,127</b>	<b>100%</b>	<b>2,417,343</b>	<b>100%</b>	<b>2,418,267</b>	<b>100%</b>
流動負債	1,110,231	33%	349,461	14%	314,916	13%
非流動負債	476,842	14%	266,474	11%	280,535	12%
<b>負債總計</b>	<b>1,587,073</b>	<b>46%</b>	<b>615,935</b>	<b>25%</b>	<b>595,451</b>	<b>25%</b>
普通股股本	406,218	12%	406,218	17%	406,218	17%
資本公積	212,941	6%	253,563	10%	253,563	10%
保留盈餘	1,216,044	36%	1,137,772	47%	1,161,517	48%
其他權益	(7,149)	0%	3,855	0%	1,518	0%
<b>權益總計</b>	<b>1,828,054</b>	<b>54%</b>	<b>1,801,408</b>	<b>75%</b>	<b>1,822,816</b>	<b>75%</b>
<b>負債與權益總計</b>	<b>3,415,127</b>	<b>100%</b>	<b>2,417,343</b>	<b>100%</b>	<b>2,418,267</b>	<b>100%</b>

註：2017年8月起合併資產負債表包含寶虹科技

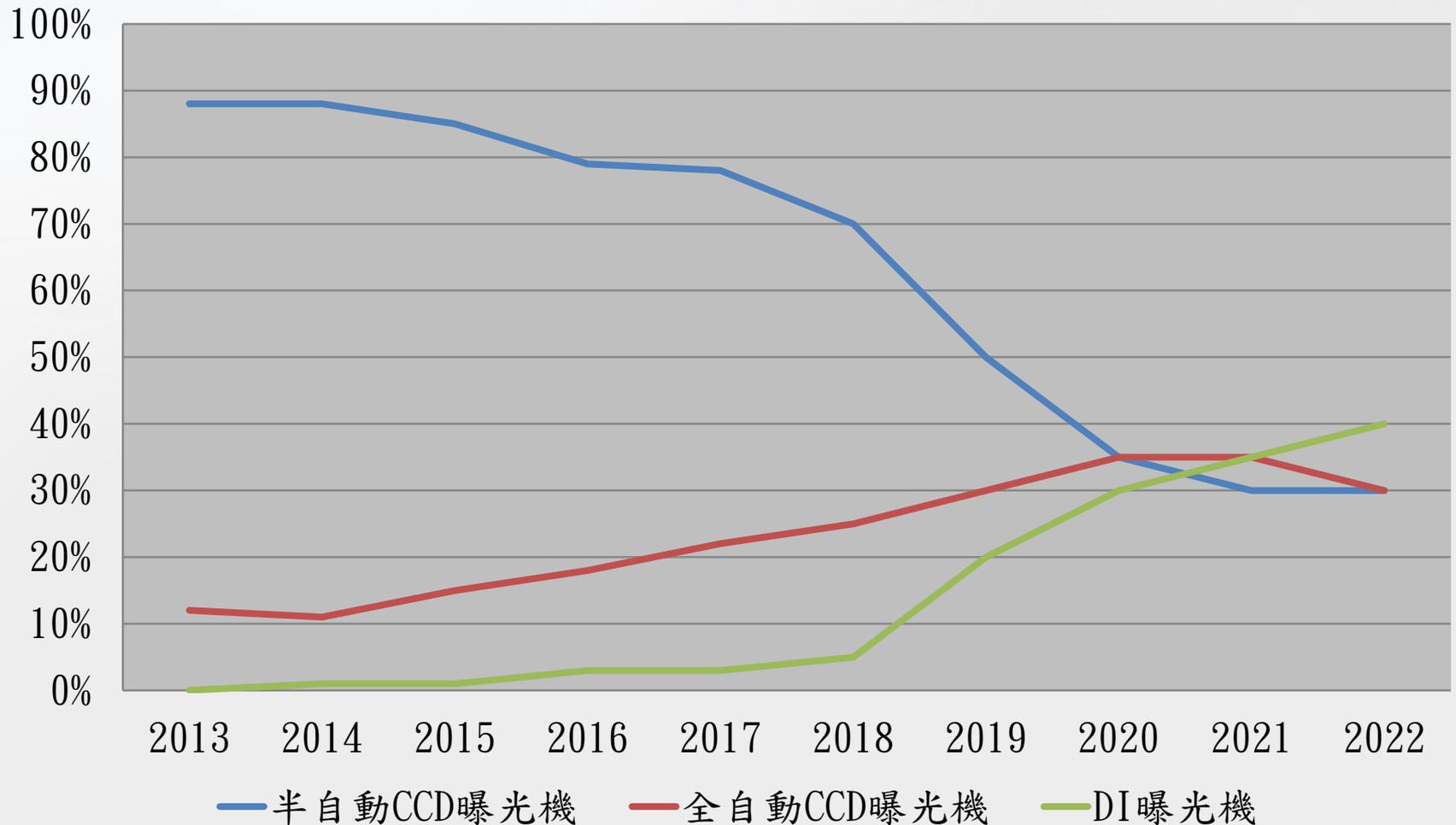
# 台灣PCB 產業技術發展藍圖

Line Width/ Spacing	Traditional Multilayer PCB			HDI/ELIC			High Layer Count		
	2017	2019	2021	2017	2019	2021	2017	2019	2021
Inner Layer	50μm/50μm	50μm/50μm	30μm/30μm	25μm/25μm	20μm/20μm	20μm/20μm	50μm/50μm	40μm/40μm	30μm/30μm
Outer Layer	50μm/50μm	50μm/50μm	30μm/30μm	30μm/30μm	25μm/25μm	25μm/25μm	60μm/60μm	40μm/40μm	30μm/30μm
Line width tolerance	8μm	8μm	6μm	6μm	6μm	6μm	6μm	6μm	6μm

Line Width/ Spacing	FPC			Rigid-Flex			PP Type Substrate		
	2017	2019	2021	2017	2019	2021	2017	2019	2021
Inner Layer	10μm/10μm	9μm/9μm	8μm/8μm	30μm/30μm	30μm/30μm	25μm/25μm	12μm/12μm	8μm/10μm	7μm/7μm
Outer Layer	20μm/20μm	15μm/15μm	10μm/10μm	40μm/40μm	40μm/40μm	30μm/30μm	10μm/10μm	8μm/8μm	5μm/5μm
Line width tolerance	4μm	3μm	2μm	8μm	8μm	5μm	4μm	3μm	3μm

資料來源:台灣電路板協會

# 曝光機產品比重預估



# 營運策略—營運成長四動能

綠能需求-傳統汞燈UV  
LED 綠能化



2018/Q2  
Titan 8000  
35 $\mu$ m DI 直接成像曝光機



2018/Q4  
Titan 9000  
25 $\mu$ m/15 $\mu$ m  
DI 直接成像曝光機



工業4.0  
SCES/GEM  
解決方案

併購子公司  
BHT進軍半導體



# 寶虹科技簡介



Equipment Solution & Service Provider For Wafer Fabrication System



# 公司簡介

- 設立日期：2006年04月25日
- 營業範圍：半導體設備銷售、零組件維修、再生業務，  
整廠轉移解決方案
- 資本額：新台幣一億八千三百萬元
- 總經理：呂理宏
- 公司：新竹市 30065，台灣省
- 公司所在地：新竹市
- 員工人數：55

# 公司簡介

2006

寶虹科技股份有限公司設立。  
Applied Materials 簽訂為期五年獨家服務合約  
(Exclusive Service Outsource Contract)。

2006

October 2006 - 與應用材料公司Applied  
Materials 簽訂為期五年獨家服務合約  
(Exclusive Service Outsource Contract)。

2007

July 2007 - 成立半導體主零組件再生、維  
修中心，並先後獲OEM 及國內晶圓大廠  
設備認證。

2008

December 2008 - 麥格理電子商業半導  
體事業部 (Macquarie Electronics) - 通過  
認證。

2009

通過英國勞氏 ISO 9001 品質管理系統認證。  
成立設備研發與翻修中心，與國內一線大廠  
合作，完成首台CVD(氣相化學沈積)設備銷售  
、安裝並順利投入客戶生產線。

2010

通過應用材料公司Applied Materials  
ISAT 零組件再生、維修中心認證。

2011

Feb 2011 - 成立 MKS RPS (遠端電漿生成器) 再生  
、維修中心。

June 2011 - 導入ERP system (企業資源規劃)。

2012

October 2011 - Knowledge Management (KM)  
lessons-learned system launched

2013

May 2013 - 與日本三井住友銀行租賃暨電子事業  
部 (SMFL) 簽訂合作協議。

2015

April 2015 - 併入翔名科技成為其100%子公司

2016

December 2016 - 台積電 AML DPS-Metal JPD  
project succeeded.

2017

Aug 2017 - 併入川寶科技股份有限公司成為其  
100%子公司

# 重要公司發展歷程

品牌及客戶  
忠誠度建立

Apr 2016

通過ISO 9001 /完  
成首台  
付一線

標準化

Jun 2012

服務創新

成立 (A Team) ,  
結合台灣協力廠及  
原廠資源提供大陸  
在地化即時服務

成立零組件再  
生及維修中心

Jun 2009

Jun 2010

Oct 2006

Apr 2008

組織再造

與原廠 (Applied  
Materials) 簽訂五年  
獨家代理服務合同



# 主要產品及服務說明

# 全方半導體設備位解決方案

我們團隊及平台提供客戶更具選擇的解決方案，結合了多種渠道和資源以支持不同客戶們的需求

# 我們的競爭優勢

## The Competitive Advantages



較低的取得成本： $< 60\%$  of OEM Cost

- Utilized existing equipment platform from surplus market with complete local supply chain management.



較快速的架線時間： $< 40\%$  Time Saving

- Localization to not only reduce the cost of materials but also lead time.



可靠持續的品質： $100\%$  Acceptance

- OEM Certified, Continue supplying to key customers & regions.

# 公司營運展望

- 公司業務以半導體八英寸設備之相關服務為主，除逐步提升十二英寸相關設備之製程能力，本公司亦積極參與業界之關鍵零組件及設備開發等合作案，以期提高設備零件自製率。
- 聯網跟汽車電子是推動八吋晶圓復甦的主要推手。為滿足未來的市場需求，台灣業者不僅紛紛將現有廠房的產能拓展到極限，同時也規劃興建全新八吋晶圓廠計畫。
- 與國內一線大廠的設備與軟體開發已經進入最後收割階段，寶虹於短期間內將恢復成長動能，另受到中國半導體扶持政策影響，預期未來業績亦將有明顯的成長題材。



# Thank you!

## Q & A